

非硅型导热吸波厚垫片 XK-JN20®

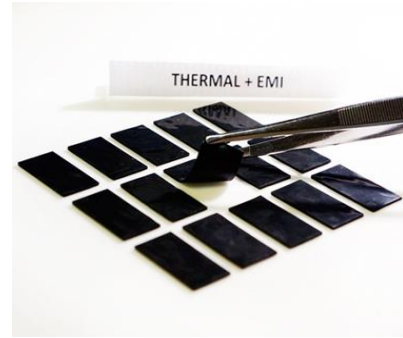
同时具有热对策和电磁波对策，能在有限空间与时间解决问题，简化机构设计，有效降低设计成本柔软的非硅材料同时保持无挥发与柔软特性，有效减少内部应力及容许公差，使终端产品设计更高可靠度。

特性:

具有宽带的吸波能力、

更佳添补空隙能力

无硅故障问题



应用：

手机、通讯设备、摄像机、高频模块、软性电路板

规格	unit	XK-JN20	Method
颜色 Color		Dark Gray	visual
厚度 Thickness	mm	0.5~3.0	ASTM D374
比重 Specific Gravity	g/cm ³	4	ASTM D792
硬度 Hardness	Asker C	20	JIS K7312
	Shore 00	55	ASTM D2240
热阻抗 Thermal impedance@0.5mm	°Cin ² /W	0.67	ASTM D5470
导热系数 Thermal Conductivity	W/mK	2	HOT DISK
Permeability	1	10	1Mhz
Permeability	1	2	1Ghz
抗张强度 Tensile strength	psi	40	ASTM D149
伸长率 Elongation	%	30	ASTM D149
硅氧烷挥发 Siloxane VolatilesD4~D20	%	0	GC-FID
阻燃性 Flammability	UL94	V-0	UL94